

## ВОЗДЕЙСТВИЕ СВЕТА НА ПРОЦЕСС ИМПЛАНТАЦИИ ИОНОВ Р<sup>+</sup> В Si

В. В. Артамонов, М. Я. Валах, А. В. Денисов,  
В. Н. Мордкович, Б. Д. Нечипорук

Институт полупроводников Академии наук Украины, 252650, Киев, Украина  
(Получена 28.05.1992. Принята к печати 8.06.1992)

Методами спектроскопии комбинационного рассеяния света изучено влияние подсветки в процессе имплантации в Si ионов Р<sup>+</sup> на разупорядочение структуры Si. Установлено, что подсветка приводит к увеличению размеров микрокристаллитов и объемного содержания кристаллической фазы в имплантируемом слое по сравнению с имплантацией без подсветки, а в аморфной фазе — к уменьшению величины отклонения углов связей ( $\Delta\theta$ ) от идеальной тетраэдрической координации.

В настоящее время широко используется модификация структуры и свойств приповерхностных слоев твердых тел путем воздействия ионными, электронными или лазерными пучками. В полупроводниковом материаловедении и микроэлектронной технологии наиболее широко используется ионная имплантация. Она позволяет легко управлять количеством и распределением инжектированных атомов. Проблема сопровождающего имплантацию разупорядочения структуры (вплоть до аморфизации при больших дозах) решается с помощью использования последующих отжигов, которые одновременно обеспечивают и электрическую активацию имплантированных атомов легирующей примеси. Для отжига имплантационных дефектов применяются термическое, ионно-лучевое и лазерное воздействия.

В последние годы появилось несколько работ [1–3], в которых было показано, что в процессе светового облучения аморфных слоев может происходить не только изменение их структуры, но и фазовый переход из аморфного состояния в кристаллическое. Целью настоящей работы является изучение влияния светового воздействия в процессе имплантации кристаллического кремния на разупорядочение его структуры.

В качестве метода исследования использовано лазерное комбинационное рассеяние света (КРС), которое позволяет не только качественно, но и количественно характеризовать процессы структурного разупорядочения [4, 5].

### Методика эксперимента

Исследовались пластины монокристаллического Si (КЭФ-4.5) *n*-типа проводимости с ориентацией (100), прошедшие стандартную химико-механическую обработку. В пластины при комнатной температуре имплантировались ионы Р<sup>+</sup> с энергией  $E = 150$  кэВ в интервале доз  $(0.2 \div 3.0) \cdot 10^{15}$  см<sup>-2</sup> при плотности тока  $j = 0.1$  мкА/см<sup>2</sup>. Пластины разворачивали на 7°, поэтому эффект канализования исключался. Одна серия образцов подвергалась имплантации при одновременной подсветке галогенной лампой (удельная мощность  $\sim 0.1$  Вт/см<sup>2</sup>). Подсветка осуществлялась в видимой и ультрафиолетовой областях спектра, что достигалось с помощью фильтра, обрезавшего ИК излучение. На другой серии образцов имплантация проводилась в идентичных условиях, но без подсветки.

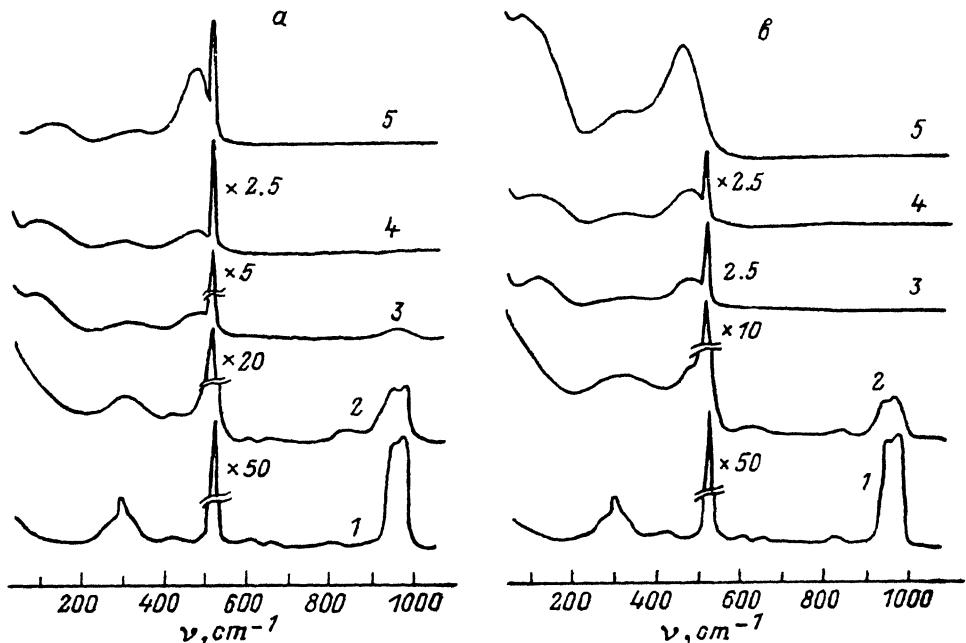


Рис. 1. Спектры КРС Si. а — образцы исходный (1) и имплантированные с подсветкой ионами Р<sup>+</sup> (2—5). Дозы, см<sup>-2</sup>: 2 — 2 · 10<sup>14</sup>, 3 — 7.5 · 10<sup>14</sup>, 4 — 1 · 10<sup>15</sup>, 5 — 3 · 10<sup>15</sup>. б — образцы исходный (1) и имплантированные ионами Р<sup>+</sup> (2—5). Дозы, см<sup>-2</sup>: 2 — 2 · 10<sup>14</sup>, 3 — 7.5 · 10<sup>14</sup>, 4 — 1 · 10<sup>15</sup>, 5 — 3 · 10<sup>15</sup>.

Спектры КРС измерялись на автоматизированной установке со спектрометром ДФС-24. Для регистрации использовался охлаждаемый ФЭУ-136 в режиме счета фотонов. Источником возбуждения служил аргоновый лазер ( $\lambda = 514.5$  нм). Во избежание нагрева образцов мощность возбуждающего излучения во всех случаях не превышала 100 мВт, а фокусировка осуществлялась цилиндрической линзой. Геометрия эксперимента соответствовала схеме измерения отражения.

### Экспериментальные результаты и их обсуждение

На рис. 1 показаны спектры КРС исходного образца (1) и четырех образцов, имплантированных различными дозами ионов Р<sup>+</sup> с подсветкой (а) и без подсветки (б). В спектре исходного образца, кроме рассеяния на длинноволновых оптических фононах центра зоны Бриллюэна, которому отвечает интенсивная симметричная линия при  $\nu = 520$  см<sup>-1</sup> с полушириной  $\Gamma = 3.8$  см<sup>-1</sup>, проявляются известные, более слабые структуры при  $\nu \approx 300$  и 1000 см<sup>-1</sup>, обусловленные процессами рассеяния второго порядка на акустических и оптических колебаниях решетки.

С ростом дозы имплантации наблюдаются уменьшение интенсивности fundamentalной полосы рассеяния, сдвиг ее в низкочастотную сторону и асимметричное увеличение полуширины с оттенением низкочастотного крыла. Кроме того, резко уменьшается интенсивность двухфононных полос до полного их исчезновения. Такие изменения спектра КРС являются характерным проявлением разупорядочения кристаллической структуры.

В то же время в спектре возникают и с ростом дозы возрастают две широкие полосы при  $\nu \approx 130$  и 480 см<sup>-1</sup>. Они индуцированы разупорядочением и обусловлены процессами рассеяния на фононах акустической (ТА) и оптической

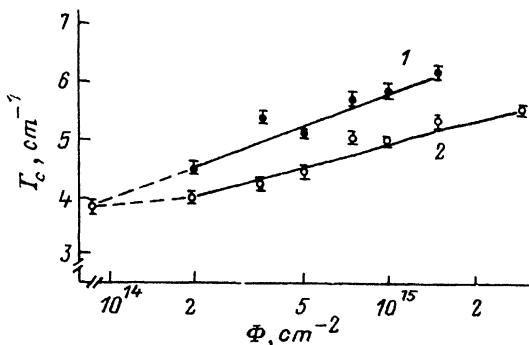


Рис. 2. Зависимости полуширины  $\Gamma_c$  фундаментальной полосы КРС Si от дозы имплантированных ионов  $P^+$  без подсветки (1) и с подсветкой (2) в процессе имплантации.

(ТО) ветвей с произвольным волновым вектором. Полоса  $\nu = 480 \text{ см}^{-1}$  является известной характеристической полосой аморфной фазы Si. Эти изменения свидетельствуют о том, что с увеличением дозы имплантации происходит уменьшение объемного содержания кристаллической и увеличение аморфной фаз.

Из сравнения *a* и *в* (рис. 1) видно, что в случае подсветки все отмеченные изменения спектров КРС происходят в меньшей мере. Так, в результате имплантации без подсветки при дозе  $\Phi = 3 \cdot 10^{15} \text{ см}^{-2}$  исследуемый слой находится полностью в аморфном состоянии, а с подсветкой представляет собой смесь аморфной и кристаллической фаз, о чем свидетельствует присутствие в спектре слабой фундаментальной полосы  $\nu = 520 \text{ см}^{-1}$ . Таким образом, подсветка образца ультрафиолетовым и видимым излучением в процессе имплантации существенно влияет на процессы разупорядочения кристаллической структуры. Для более детального изучения этого влияния нами далее количественно проанализированы изменения спектров КРС.

*Анализ изменений в кристаллической фазе.* На рис. 2 показана зависимость полуширины  $\Gamma_c$  полосы  $\nu = 520 \text{ см}^{-1}$  от дозы ионов  $P^+$ . Видно, что при имплантации без подсветки происходит монотонное увеличение  $\Gamma_c$  от  $3.8 \text{ см}^{-1}$  при дозе  $\Phi = 1.5 \cdot 10^{15} \text{ см}^{-2}$ . При  $\Phi = 3 \cdot 10^{15} \text{ см}^{-2}$  эта полоса в спектре КРС не регистрируется. В случае имплантации с подсветкой полуширина также увеличивается, но в меньшей степени, причем она наблюдается и при  $\Phi = 3 \cdot 10^{15} \text{ см}^{-2}$  ( $\Gamma_c = 5.5 \text{ см}^{-1}$ ).

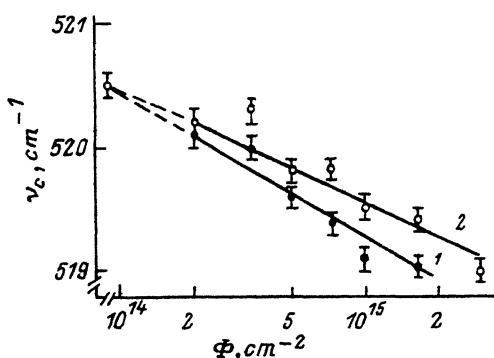


Рис. 3. Зависимости частотного положения  $\nu_c$  фундаментальной полосы КРС Si от дозы имплантированных ионов  $P^+$  без подсветки (1) и с подсветкой (2) в процессе имплантации.

На рис. 3 показана зависимость частотного положения полосы от дозы имплантации. Видно, что в обоих случаях происходит уменьшение  $\nu_c$  с ростом дозы, причем значения  $\nu_c$  при имплантации без подсветки ниже, чем с подсветкой.

Полученные результаты могут быть проанализированы на основе модели «пространственной корреляции фононов», используемой для описания размерных эффектов в спектрах КРС при разупорядочении кристаллической структуры [6, 7]. В основе модели лежат соображения о пространственной локализации волновой функции фононов в области, для которой сохраняется упорядоченное расположение атомов. Соответствующая функция  $W(r, L)$ , модулирующая волновую функцию идеального кристалла, задается, например, распределением Гаусса

$$W(r, L) = A \exp(-q^2 L^2 / 4),$$

где  $L$  — длина корреляции. В таком случае выражение для интенсивности КРС в микрокристаллите, аппроксимируемом сферой диаметром  $L$ , имеет вид

$$I(\omega) \propto \int \exp(-q^2 L^2 / 4) \frac{d^3 q}{[\omega - \omega(q)]^2 + (\Gamma_0/2)^2},$$

где  $q$  — волновой вектор, определяемый в единицах, характеризующих размер зоны Бриллюэна,  $\Gamma_0$  — полуширина фундаментальной полосы КРС исходного идеального монокристалла (т. е. при  $L \rightarrow \infty$ ),  $\omega(q)$  — закон дисперсии фононов. Из последнего выражения следует, что размерный эффект обуславливает как уширение полосы рассеяния, так и смещение ее в низкочастотную сторону. При количественном сопоставлении предполагается выбор значений длин корреляции  $L$ , при которых рассчитанный асимметричный контур согласуется с экспериментально измеренным.

Так как в случае имплантации без подсветки полуширина больше, а значение  $\nu_c$  меньше, чем при подсветке, размеры микрокристаллитов в первом случае меньше, чем во втором. Например, при увеличении дозы имплантации от  $2 \cdot 10^{14}$  до  $3 \cdot 10^{15} \text{ см}^{-2}$  без подсветки размеры микрокристаллитов уменьшаются от 60 до 30 Å, а с подсветкой — от 130 до 38 Å. Это свидетельствует о том, что при подсветке замедляется процесс разупорядочения кристаллической структуры.

Эти результаты коррелируют с изменениями интенсивности фундаментальной полосы рассеяния. В работе [8] было предложено использовать для характеристики степени разупорядочения кристаллической структуры Si величину

$$\xi = 1 - \frac{I_{\text{im}}}{I_0},$$

где  $I_0$  — интенсивность фундаментальной полосы исходного образца, а  $I_{\text{im}}$  — имплантированного.

На рис. 4 показана зависимость величины  $\xi$  от дозы имплантации. Видно, что значения  $\xi$  при имплантации без подсветки выше, чем с подсветкой. При  $\Phi = 3 \cdot 10^{15} \text{ см}^{-2}$  без подсветки  $\xi = 1$ , что отражает факт полной аморфизации исследуемого слоя, тогда как при подсветке  $\xi < 1$ .

*Анализ изменений в аморфной фазе.* Нами также были проанализированы структурные изменения, протекающие в аморфной фазе. В ряде работ, где обсуждались структурные модели аморфного кремния, показано, что не существует непрерывного топологического перехода от кристаллической структуры к аморфной, и наоборот [9]. Для аморфного кремния устойчивы структуры, в которых среднее квадратичное отклонение углов связей  $\bar{\Delta}\theta$  от идеальной тетраэдрической координации монокристалла Si превышает  $6.6^\circ$ . Структур с промежуточными значениями  $0 < \bar{\Delta}\theta < 6.6^\circ$  не существует, т. е. переход Si из аморфного состояния в кристаллическое, и наоборот, носит скачкообразный характер. При

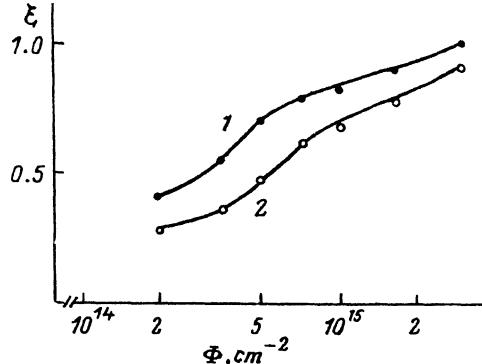


Рис. 4. Зависимость величины  $\xi$  от дозы имплантированных ионов  $P^+$  без подсветки (1) и с подсветкой (2) в процессе имплантации.

в этом изменение полуширины  $TO$ -полосы аморфного кремния ( $\nu \approx 480 \text{ см}^{-1}$ ) в спектре КРС непосредственно коррелирует с величиной  $\overline{\Delta\theta}$  [<sup>9</sup>]:

$$\Gamma_a^2 = \Gamma_0^2 + \Gamma_\theta^2 = (32)^2 + (6.74 \overline{\Delta\theta})^2,$$

где  $\Gamma_a$ ,  $\Gamma_0$  и  $\Gamma_\theta$  выражены в  $\text{см}^{-1}$ , а  $\overline{\Delta\theta}$  — в градусах.

На рис. 5 показаны изменения полуширины  $TO$ -полосы  $\Gamma_a$  и величины  $\overline{\Delta\theta}$  с дозой имплантации. Видно, что с увеличением дозы до  $7.5 \cdot 10^{14} \text{ см}^{-2}$  величина  $\overline{\Delta\theta}$  практически не изменяется, а при больших дозах увеличивается. При имплантации без подсветки она изменяется от  $8.3$  до  $12.5^\circ$ , а с подсветкой — от  $7$  до  $13^\circ$ . Таким образом, величина  $\overline{\Delta\theta}$  при относительно малых дозах имплантации без подсветки имеет большее значение, чем с подсветкой, но с увеличением дозы эта разница уменьшается и при  $\Phi = 3 \cdot 10^{15} \text{ см}^{-2}$  значения  $\overline{\Delta\theta}$  практически совпадают. Это свидетельствует о том, что подсветка влияет на степень неравновесности аморфной фазы, так как величина  $\overline{\Delta\theta}$  определяет запасенную упругую энергию.

Известно [<sup>10</sup>], что к изменению частотного положения  $TO$ -полосы аморфного Si могут привести три фактора: а) механические напряжения, б) изменения величины  $\overline{\Delta\theta}$ , в) присутствие значительной концентрации атомов водорода. В нашем случае последнюю причину можно исключить.

Как видно из рис. 6, с увеличением дозы имплантации частота  $TO$ -полосы  $\nu_a^{TO}$  уменьшается, причем ее значение при имплантации без подсветки ниже,

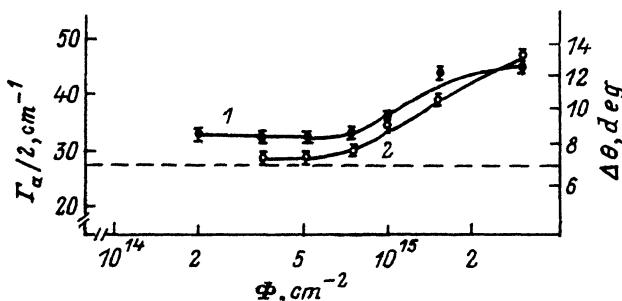


Рис. 5. Зависимость полуширины  $\Gamma_a$  ( $\overline{\Delta\theta}$ )  $TO$ -полосы от дозы имплантированных ионов  $P^+$  без подсветки (1) и с подсветкой (2) в процессе имплантации. Штриховой линией показано минимально возможное значение величины  $\overline{\Delta\theta}$  для  $a\text{-Si}$ .

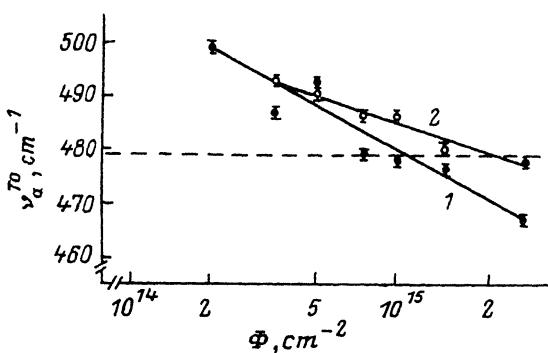


Рис. 6. Зависимость частотного положения  $\nu_{\alpha}^{TO}$  ТО-полосы  $\alpha$ -Si от дозы имплантированных ионов  $P^+$  без подсветки (1) и с подсветкой (2) в процессе имплантации. Штриховой линией показано теоретическое значение частотного положения ТО-полосы ненапряженного, беспримесного  $\alpha$ -Si.

чем с подсветкой. Так как при  $\Phi = 7.5 \cdot 10^{14} \text{ см}^{-2}$  величина  $\bar{\Delta}\theta$  практически не изменяется, смещение полосы в данном диапазоне доз следует связать с уменьшением сжимающих напряжений. При  $\Phi = 7.5 \cdot 10^{14} \text{ см}^{-2}$ , где  $\bar{\Delta}\theta$  увеличивается, дальнейшее уменьшение  $\nu_{\alpha}^{TO}$ , по-видимому, обусловлено как уменьшением сжимающих напряжений, так и ростом  $\bar{\Delta}\theta$ , поскольку рост  $\bar{\Delta}\theta$  также должен приводить к низкочастотному сдвигу [11]. При  $\Phi = 3 \cdot 10^{15} \text{ см}^{-2}$  значения  $\bar{\Delta}\theta$  для обоих случаев имплантации одинаковы. Поэтому различия в частотном положении ТО-полосы обусловлены лишь действием механических напряжений. Следовательно, при имплантации с подсветкой в аморфной фазе действуют большие сжимающие напряжения, чем без подсветки.

Для количественного определения объемного содержания  $\rho$  кристаллической фазы в смешанной системе мы воспользовались соотношением работы [12]

$$\rho = \frac{I_c}{I_c + yI_a} \cdot 100 \%,$$

где  $I_c$  и  $I_a$  — интегральные интенсивности фундаментальной и ТО-полос в спектрах КРС,  $y$  — отношение сечений рассеяния кристаллического и аморфного кремния. В литературе приводятся разные значения  $y$  — от 0.1 до 0.88. В работе [13] было предложено определять величину  $y$  в зависимости от размера микрокристаллитов с использованием выражения

$$y = 0.1 \exp(-L/250),$$

где  $L$  — размер микрокристаллитов в Å.

Воспользовавшись приведенным значением размеров микрокристаллитов, оценим объемное содержание кристаллической фазы в имплантированных образцах. На рис. 7 показана ее зависимость от дозы имплантации. Видно, что в случае имплантации с подсветкой величина  $\rho$  превышает соответствующие значения для случая имплантации без подсветки. С увеличением дозы она уменьшается в обоих случаях имплантации, что обусловлено ростом перекрытия отдельных аморфных областей, и при дозе  $\Phi = 3 \cdot 10^{15} \text{ см}^{-2}$  достигает значения  $\rho = 0$  в случае имплантации без подсветки. При подсветке ее значение уменьшается только до 50%.

При проникновении энергетического иона в твердое тело кинетическая энергия, сообщаемая атомам решетки при ядерных столкновениях, может быть достаточной, для того, чтобы вызвать смещение атомов и возникновение отдель-

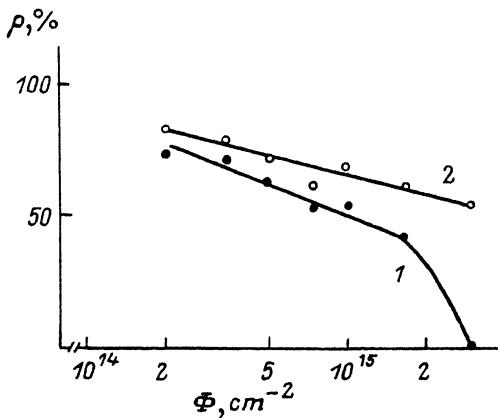


Рис. 7. Изменение объемного содержания кристаллической фазы с дозой имплантированных ионов  $P^+$  без подсветки (1) и с подсветкой (2) в процессе имплантации.

ных аморфных зон, окружающих каждый ионный трек. Увеличение дозы имплантации приводит к тому, что отдельные аморфные зоны начинают перекрываться вплоть до образования сплошного аморфного слоя. Такая картина наблюдается в интервале глубин от  $R_p - \Delta R_p$  до  $R_p + \Delta R_p$ , где  $R_p$  — проекционный пробег иона, а  $\Delta R_p$  — его среднеквадратичное отклонение. В нашем случае  $R_p = 187$  нм, а  $\Delta R_p = 48$  нм [15]. На глубинах, отличающихся от указанных, число ядерных соударений невелико и преобладающим типом повреждений должны быть изолированные кластеры, в состав которых входят точечные дефекты, такие как вакансии и междуузельные атомы.

При не слишком низких температурах имплантации нарушение кристаллической структуры происходит под действием двух конкурирующих механизмов — разупорядочения и отжига. Можно предположить, что исследованное нами влияние подсветки в процессе имплантации способствует проявлению механизмов отжига. В пользу этого предположения свидетельствует тот факт, что при подсветке размеры микрокристаллитов больше, а объемное содержание кристаллической фазы в смешанной системе выше. По-видимому, под действием светового излучения происходит развал дефектных комплексов и возникшие при этом вакансии и междуузельные атомы диффундируют к границам раздела аморфных и кристаллических областей, где происходит твердофазная кристаллизация. В этих процессах существенную роль играют нарушенные области, находящиеся на глубинах, меньших  $R_p - \Delta R_p$  и больших  $R_p + \Delta R_p$ , где максимальна концентрация изолированных кластеров.

Возможна другая точка зрения. В работе [15] было показано, что под действием светового излучения в аморфном Si происходят обратимые переходы из одного метастабильного состояния аморфной фазы в другое. Одним из таких возможных метастабильных состояний может быть кластер размером  $< 30$  Å вюрцитной структуры. Если размер такого кластера увеличивается до 30 Å, то возможна его перестройка в обычную алмазоподобную структуру. Этим авторы работы [15] объясняли квазипериодическое влияние и исчезновение слабой по интенсивности фундаментальной полосы рассеяния в спектре КРС аморфного Si.

Можно предположить, что в случае, когда перестройка такого кластера происходит на границе раздела  $a\text{-Si}-c\text{-Si}$ , вероятность обратной его перестройки резко уменьшается. Этот процесс, по-видимому, также может вносить свой вклад

в увеличение размера микрокристаллитов в случае имплантации с подсветкой, что в конечном итоге ведет к увеличению относительного объема кристаллической фазы в исследуемых слоях.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- [1] В. Н. Денисов, Б. Н. Маврин, В. Б. Подобедов, Г. Г. Скрапская. ЖЭТФ, 50, 363 (1989).
- [2] I. Abdulhalim, R. Beserman, Yu. L. Khait. J. Non.-Cryst. Sol., 97-98, 387 (1987).
- [3] M. Ohsawa, T. Hama, T. Akasaka, H. Sakai, S. Ishida, Y. Uchida. J. Non-Cryst., 97-98, 91 (1987).
- [4] B. B. Artamonov, M. Я. Валах, M. П. Лисица, B. Г. Литовченко, B. Н. Романюк, И. В. Рудской, B. B. Стрельчук. ФТП, 22, 1961 (1988).
- [5] V. V. Artamonow, V. S. Lysenko, A. N. Nazarov, V. V. Strelchuk, M. Ya. Valakh. Semicond. Sci. Techn., 6, 1 (1991).
- [6] A. K. Shukla, K. P. Jain. Phys. Rev. B, 35, 9240 (1987).
- [7] H. Richter, Z. P. Wang, L. Ley. Sol. St. Commun., 39, 625 (1980).
- [8] I. H. Campbell, P. M. Fauchet. Sol. St. Commun., 58, 739 (1986).
- [9] K. Mizoguchi, S. Nakashima, A. Fujii, A. Mitsuiishi, H. Morimoto, H. Onoda, T. Kato. Japan. J. Appl. Phys., 26, 903 (1987).
- [10] D. Beeman, R. Tsu, M. H. Thorple. Phys. Rev. B, 32, 874 (1985).
- [11] Y. Hisshikawa. J. Appl. Phys., 62, 3150 (1987).
- [12] R. Tsu. J. Non.-Cryst., 97-98, 163 (1987).
- [13] T. Okada, T. Iwaki, H. Kasahara, K. Yamamoto. Japan J. Appl. Phys., 24, 161 (1985).
- [14] E. Bustarret, M. A. Hachicha, M. Brunel. Appl. Phys. Lett., 52, 1676 (1988).
- [15] I. Abdulhalim, R. Beserman, R. Weil. Phys. Rev. B, 39, 1081 (1989).

Редактор Л. В. Шаронова

---